

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2023-015

通富微电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,511,563,863 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
传真	0513-85058929	0513-85058929	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期主要业务或产品简介

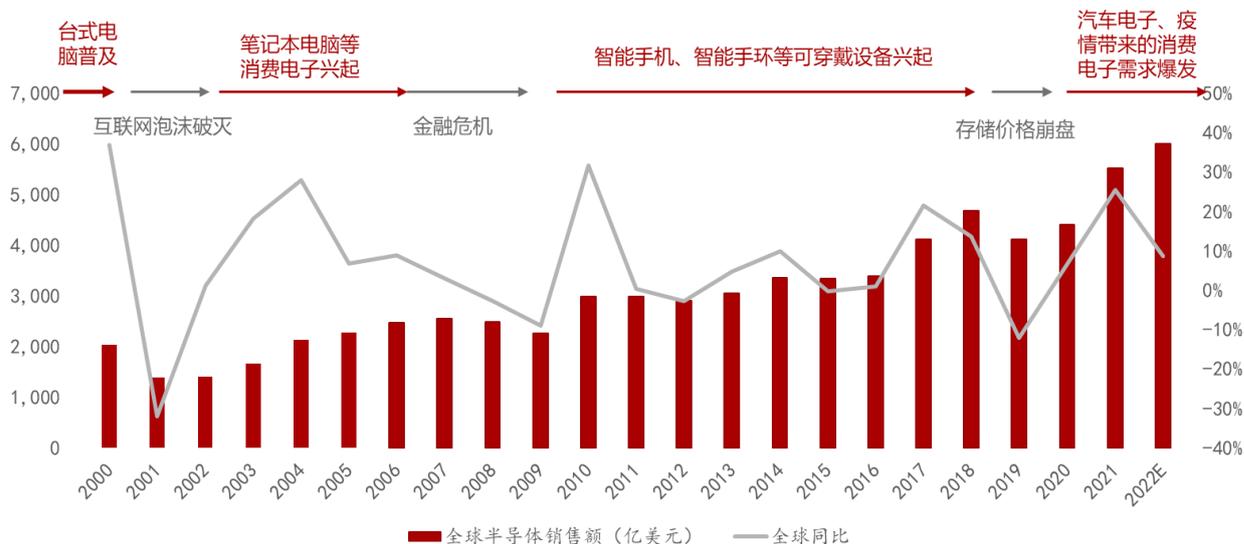
（1）报告期内公司所处行业情况

2022 年，受欧洲地缘政治风险升级、美国持续高通胀等外部因素影响，全球经济面临巨大挑战，全球经济前景的不确定性导致行业需求下降，集成电路下游终端应用市场出现了较为明显的结构性失衡：从下游应用端看，汽车电子市

场发展迅猛，但汽车应用在集成电路市场中占比还不高；与此同时，计算机与通信仍是主要拉动力，而计算机市场处于饱和乃至部分萎缩状态，以智能手机为代表的通信市场进入调整期，库存高企。上述情况导致集成电路行业景气度下降，2022 年第二季度开始集成电路销售额增速逐季下滑。随着全球经济回暖，AI、数据中心、5G、智能汽车等新兴应用端需求持续发展，2023 年集成电路产业有望触底并逐渐复苏。

1、全球半导体行业短期面临挑战，长期前景乐观

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022 年全球半导体市场规模为 5,735 亿美元，同比增长 3.2%，与 2021 年的 26.2% 相比显著放缓。企业和个人电脑及智能手机的需求疲软，芯片库存水平上升，内存市场持续疲软等不利条件，限制了半导体市场的增长。



资料来源：WSTS，浙商证券研究所

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，全球半导体市场在 2022 年经历了很大的起伏，年初的销售额创下历史新高，但在年底却出现了周期性的低迷。销售额短期波动是市场周期性变动和宏观经济条件所导致的，但由于芯片在推动万物世界变得更智能、更高效、更互联方面的作用越来越大，使得半导体市场的长期前景仍然非常可观。

2022 年以来全球各国强化本国半导体政策支持力度，美国、欧盟、日本、韩国、印度等国家相继出台产业政策，通过基金支持、设备补贴、税收优惠等方式予以政策扶持。

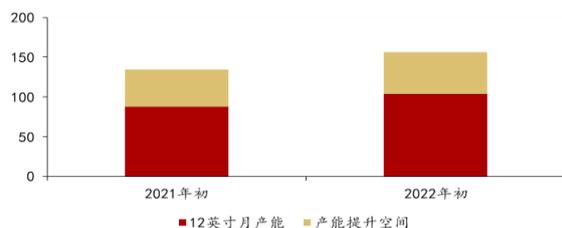
虽然产业在 2023 年发展过程中要面对独特又艰巨的挑战，但全球半导体行业发展的长期基本面仍然保持强劲。

2、中国仍为全球最大的半导体单一市场，国内晶圆厂建设利好封测环节

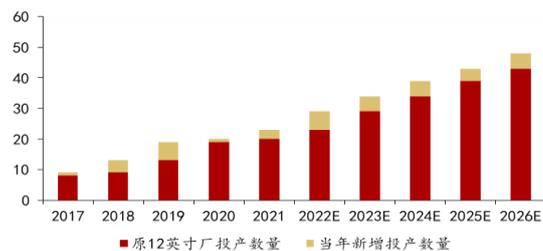
美国半导体行业协会（SIA）近日发布报告指出，中国大陆仍然是全球最大的半导体单一市场，2022 年总销售额达到 1,803 亿美元，较 2021 年减少了 6.3%，但占比仍接近 32.5%。

半导体政策支持力度强化，晶圆厂纷纷宣布扩产计划。据统计，2022 年中国大陆共有 23 座 12 英寸晶圆厂正在投产，总计月产能约为 104.2 万片，与总规划月产能 156.5 万片相比，产能装载率仅达到 66.58%，仍有较大扩产空间。预计中国大陆 2022 年-2026 年还将新增 25 座 12 英寸晶圆厂，总规划月产能将超过 160 万片。预计截至 2026 年底，中国大陆 12 英寸晶圆厂的总月产能将超过 276.3 万片，相比目前提高 165.1%。国内头部晶圆厂逆势扩产，将为下游封测带来发展机遇。

2021-2022 中国大陆地区 12 英寸晶圆厂月产能 (单位：万片)



2017-2026 年中国大陆地区 12 英寸厂增量预测 (单位：座)



资料来源：IC Insights，与非研究院，浙商证券研究所

3、先进封装技术突破，促行业长期发展

随着近年来智能手机、物联网、AI 以及高性能计算等终端产品朝高效能、低成本、低功耗及小面积等产品要求发展，先进制程也逐步演进到 3nm、2nm，晶片设计与制造工艺微缩的难度、成本与开发时间开始呈现跳跃式的增长。以 5nm 节点为例，仅是光刻机或者刻蚀机等设备支出高达 31 亿美元，是 14nm 的 2 倍以上，28nm 的 4 倍左右。芯片制造面临物理极限与经济效益边际提升双重挑战，如何实现芯片效能与成本之间的平衡成为行业亟待解决的痛点。

随着后摩尔时代的到来，封测环节被推向舞台的正中央。特别是，先进封装的出现，让业界看到了通过封装技术推动芯片高密度集成、性能提升、体积微型化和成本下降的巨大潜力，先进封装技术正成为集成电路产业发展的新引擎。目前，市场主流的先进封装工艺主要包括倒装焊、晶圆级封装、扇外型封装、2.5D 封装、3D 封装以及 Chiplet 封装方式等。

2022 年 12 月《小芯片接口总线技术要求》标准发布，这是中国首个原生 Chiplet 技术标准，有助于行业规范化、标准化发展，为赋能集成电路产业打破先进制程限制因素，提升中国集成电路产业综合竞争力，加速产业进程发展提供指导和支持。随着 Chiplet 小芯片技术的发展以及国产化替代进程的加速，先进封装技术在整个封装市场的占比正在逐步提升。根据 Yole 预测，全球先进封装市场预计将在 2019-2025 年间以 6.6% 的复合年增长率增长，到 2025 年将达到 420 亿美元，远高于对传统封装市场的预期；与传统封装相比，先进封装的应用正不断扩大，预计到 2026 先进封装将占到整个封装市场规模的 50% 以上。

在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet 为国产替代开辟了新思路，有望成为我国集成电路产业逆境中的突破口之一。

4、产业政策齐发，推动行业高质量发展

虽然消费终端市场不断传来需求下降的讯息，使得全球半导体市场刮起瑟瑟寒风。但我国一些地区仍陆续出台了多项集成电路产业政策，并奖励大量资金以高度支持和推动集成电路产业实现高质量发展。

2023 年 1 月，江苏省正式印发《关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策》，提出提升产业创新能力、提升产业链整体水平、形成财税金融支持合力、增强产业人才支撑、优化发展环境等 5 个大类 26 条具体措施。

2023 年 3 月 2 日，国务院副总理刘鹤调研集成电路企业时强调，“发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量”。政府端，应当制定符合国情和新形势的集成电路产业政策，帮助企业排忧解难，引导长期投资。市场端，重视发挥市场力量和产业生态作用，建立企业为主体的攻关机制，给予人才优惠政策和发挥空间，维护全球产业链供应链稳定。

集成电路产业发展需要走新型举国体制路径，半导体产业有望迎来更多政策支持。

(2) 报告期内公司从事的主要业务

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。2022 年，是公司充满挑战和变化的一年，在挑战中奋进，在变局中蜕变，在不确定的世界努力构建属于公司的确定性，共同迎接“百年未有之大变局”新时代的新挑战。

2022 年，公司积极调整产品业务结构，加大市场调研与开拓力度，持续服务好大客户，凭借 7nm、5nm、FCBGA、Chiplet 等先进技术优势，不断强化与 AMD 等行业领先企业的深度合作，巩固和扩大先进产品市占率。2022 年，公司实现营业收入 214.29 亿元，同比增长 35.52%。在全球前十大封测企业中，公司营收增速连续 3 年保持第一；2022 年，公司在全球前十大封测企业中市占率增幅第一，营收规模排名进阶，首次进入全球四强（数据来源：芯思想研究院）。

2022 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 5.02 亿元，同比下降 47.53%。受汇率波动影响，公司产生汇兑损失，因此减少归属于母公司股东的净利润 2.11 亿元。如剔除该非经营性因素的影响，公司归属于母公司股东的净利润应该为 7.13 亿元，同比下降 25.46%；另外，由于集成电路行业景气度下行，部分终端产品需求疲软，导致公司产能利用率及毛利率下降；公司加大 Chiplet 等先进封装技术创新研发投入，研发费用增加，导致利润下降。

2022 年，公司技术研发水平再创新高，构建国内最完善的 Chiplet 封装解决方案，发展国内领先的大功率模块技术，积极推动先进移动终端芯片国产化方案。2022 年，公司申请专利 165 件，先进封装技术类专利申请占比超 60%，为公司产业升级做好铺垫；专利授权量同比增长近 40%，公司喜获江苏省专利项目“优秀奖”。

2022 年，公司实施非公开发行股票，实际募集资金总额 26.93 亿元，是 A 股上市公司中唯一得到大基金一期和二期共同投资的封测公司，获苏州园丰资本、南通产控等各级政府投资平台及战略合作伙伴的投资，为公司发展奠定资金基础。

2022 年，面对风高浪急的国际环境与复杂多变的市场形势，我们凝聚了公司上下全体职工的经验与智慧，汇聚起行业、政府各方信任与支持，爬坡过坎，苦干实干，很好地完成了年初制定的营收目标任务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	35,629,428,284.40	27,101,066,163.89	31.47%	21,230,751,086.99
归属于上市公司股东的净资产	13,833,578,689.66	10,441,986,798.89	32.48%	9,578,582,586.37
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	21,428,576,599.20	15,812,232,813.96	35.52%	10,768,700,029.40
归属于上市公司股东的净利润	502,004,796.22	956,691,241.24	-47.53%	338,427,876.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,601,140.86	796,207,650.80	-55.21%	207,156,440.73
经营活动产生的现金流量净额	3,197,950,182.76	2,870,801,232.01	11.40%	2,721,298,915.81
基本每股收益（元/股）	0.37	0.72	-48.61%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.72	-48.61%	0.29
加权平均净资产收益率	4.50%	9.51%	-5.01%	4.96%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,501,738,566.38	5,065,419,078.27	5,751,983,129.83	6,109,435,824.72
归属于上市公司股东的净利润	164,696,460.27	200,719,199.13	111,341,845.09	25,247,291.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,060,007.43	166,946,489.78	80,621,908.25	-35,027,264.60
经营活动产生的现金流量净额	-164,785,573.05	3,113,118,546.58	567,392,655.07	-317,775,445.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	196,708	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	165,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	20.32%	307,541,893	0	质押	131,010,000	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	13.29%	201,082,279	0			
苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	其他	4.52%	68,399,452	68,399,452			
南通盛世金濠投资管理有限公司—南通盛富股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.71%	25,923,392	25,923,392			
南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	23,929,329	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.50%	22,678,852	0			
天津金梧桐投资管理合伙企业（有限合伙）—芜湖信远金梧股权投资合伙企业（有	其他	1.45%	21,887,824	21,887,824			

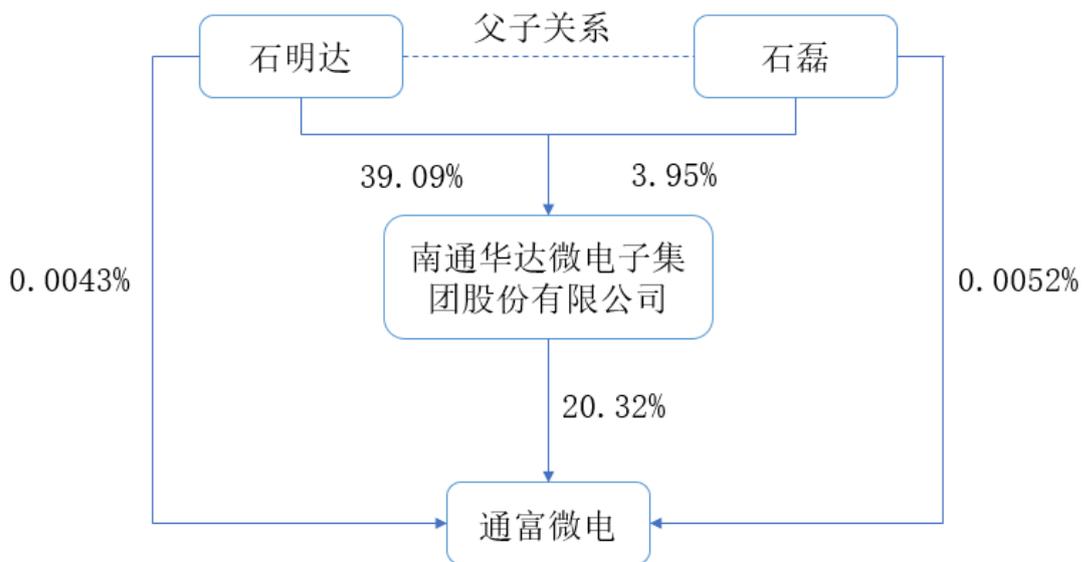
有限合伙)						
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	1.36%	20,519,835	20,519,835		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	13,859,213	0		
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	其他	0.75%	11,407,780	10,943,912		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

通富微电子股份有限公司
 董事长：石明达
 2023年3月28日